

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 7 部門第 2 区分
 【発行日】平成 19 年 7 月 19 日 (2007.7.19)

【公開番号】特開 2006-80564 (P2006-80564A)
 【公開日】平成 18 年 3 月 23 日 (2006.3.23)
 【年通号数】公開・登録公報 2006-012
 【出願番号】特願 2005-336256 (P2005-336256)
 【国際特許分類】

H 0 1 L 25/18 (2006.01)

H 0 1 L 25/07 (2006.01)

H 0 1 L 25/065 (2006.01)

【F I】

H 0 1 L 25/08 Z

【手続補正書】

【提出日】平成 19 年 6 月 1 日 (2007.6.1)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

複数の半導体 ベアチップ を搭載する 基材 と、該基材に搭載した半導体 ベアチップ とを備えた半導体装置のパッケージ構造において、

マウントすべき半導体 ベアチップ の 電極端子 を接続する内部電極と、半導体 ベアチップ マウント後の試験時に試験装置の端子が接続される試験用電極と、半導体 ベアチップ をマウントしたのち前記基材に実装される時に他の部品に接続される実装用電極とを設けた半導体チップマウントサブ基板と、

前記半導体チップマウントサブ基板を、前記基材に搭載した半導体 ベアチップ の上部に配置するスペーサと、を備え、

前記半導体チップマウントサブ基板と前記基材に搭載された半導体 ベアチップ を前記基材とともに樹脂封止したことを特徴とする半導体装置のパッケージ構造。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 1 4

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 1 4】

この発明は、複数の半導体 ベアチップ を搭載する 基材 と、該基材に搭載した半導体 ベアチップ とを備えた半導体装置のパッケージ構造において、

マウントすべき半導体 ベアチップ の 電極端子 を接続する内部電極と、半導体 ベアチップ マウント後の試験時に試験装置の端子が接続される試験用電極と、半導体 ベアチップ をマウントしたのち前記基材に実装される時に他の部品に接続される実装用電極とを設けた半導体チップマウントサブ基板と、

前記半導体チップマウントサブ基板を、前記基材に搭載した半導体 ベアチップ の上部に配置するスペーサと、を備え、

前記半導体チップマウントサブ基板と前記基材に搭載された半導体 ベアチップ を前記基材とともに樹脂封止したことを特徴としている。

【手続補正 3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 1 5

【補正方法】削除

【補正の内容】

【手続補正 4】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 1 6

【補正方法】削除

【補正の内容】

【手続補正 5】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 1 7

【補正方法】削除

【補正の内容】

【手続補正 6】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 1 8

【補正方法】削除

【補正の内容】

【手続補正 7】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 1 9

【補正方法】削除

【補正の内容】

【手続補正 8】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 2 1

【補正方法】削除

【補正の内容】

【手続補正 9】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 2 2

【補正方法】削除

【補正の内容】

【手続補正 10】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 2 3

【補正方法】削除

【補正の内容】

【手続補正 11】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 2 4

【補正方法】削除

【補正の内容】

【手続補正 12】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 2 5

【補正方法】削除

【補正の内容】